

Mate2015

21st Symposium on "Microjoining and Assembly Technology in Electronics"

第21回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

日 時： 平成27年2月3日（火）、4日（水）

場 所： パシフィコ横浜 会議センター（横浜市西区みなとみらい1丁目1-1）

主 催： （一社）スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会
（一社）溶接学会 マイクロ接合研究委員会

《エレクトロニクス製造業における生産技術の課題と次への挑戦》

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

共 催： （一社）エレクトロニクス実装学会
（公社）化学工学会 エレクトロニクス部会
（一社）レーザ加工学会

協 賛： 応用物理学会、軽金属学会、精密工学会、電子情報通信学会、日本機械学会、
日本金属学会、日本材料学会、日本溶接協会（一部依頼中を含む）

参加申込〆切：平成27年1月15日(木)

参加申込：下記シンポジウムURLより、期日までに参加登録を行って下さい。参加費のお支払いは銀行振込にてお願い致します。なお、振込期日までにお振込みが間に合わない場合は、当日現金にてお支払い願います。

【振込先】 三井住友銀行 千里中央支店 普通口座 0978673
口座名：Mate組織委員会 [メイトソシキイインカイ]

【振込期日】平成27年2月27日(金)

【URL】 <http://sps-mste.jp/mate2015/src/>

懇親会：シンポジウム1日目に懇親会を開催します。シンポジウム参加申込時にお申し込みください。

(日 時) 平成27年2月3日（火）17:45～

(場 所) パシフィコ横浜 会議センター6階
「バイブリッジカフェテリア」

(参加費) 5,000円

《参加費》

主催団体個人会員	: 15,000円
大学・国公立研究機関	: 15,000円
口頭発表者	: 15,000円
主催団体維持・賛助会員	: 20,000円
共催団体会員	: 20,000円
一 般	: 30,000円
学 生	: 5,000円

Mate 2015 プログラム

2月3日(火)

時間	A 会場	B 会場	C 会場
8:50	開会の挨拶 Mate2015組織委員会委員長 藤本 公三 (A会場)		
9:00 ~ 11:00	<p>[A-1] 接合部の寿命予測技術</p> <ol style="list-style-type: none"> 粘塑性・クリープ分離型構成モデルの陰的時間積分と安定性の検討 *林 文晴(東京工業高等専門学校), 海老原理徳(東京学芸大学), 渡邊裕彦, 浅井竜彦(富士電機株) 直接周期解法を用いたはんだ接合部の疲労寿命予測技術に関する実用化研究 *桃井義宣(パナソニック株) AuGe はんだ接合における電解 Ni めっきと無電解 Ni めっきの高温信頼性比較 *安在岳士^{1,2}, 村上善則^{1,3}, 加藤史樹^{1,4}, 谷澤秀和^{1,5}, 佐藤伸二^{1,5}, 樋山浩平^{1,6}, 高橋弘樹^{1,7}, 佐藤 弘^{1,4} 技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構(FUPET), ² カソニックカンセイ株, ³ 日産自動車株, ⁴(独)産業技術総合研究所, ⁵ サンケン電気株, ⁶株東芝, ⁷ 富士電機株 電気-熱-構造連成解析を用いた実使用環境下を考慮した車載用パワーモジュールの信頼性評価手法の研究 *森田 隼隆, 于 強(横浜国立大学) ガラスインターポーザ基板を用いた鉛フリーはんだ接合部の熱応力解析 *窪田悠人, 荘司郁夫(群馬大学), 土田徹勇起, 中村清智(凸版印刷株) 低熱膨張有機基板の反り挙動解析 *小原さゆり, 岡本圭司, 乃万裕一, 鳥山和重, 森 裕幸(日本アイ・ピー・エム株) 	<p>[B-1] はんだ材料</p> <ol style="list-style-type: none"> 鉛フリーはんだ接合体の接合強度に及ぼす添加元素の影響 *竹之内郁人, 山内啓(群馬大学) InSn 共晶はんだ合金の組織と機械的性質に及ぼす Ag 添加の影響 *上村泰紀, 清水浩三, 作山誠樹(株富士通研究所) Sn-1.0Ag-0.7Cu-1.6Bi-0.2In 低銀鉛フリーはんだの疲労特性 *高橋祐樹, 荘司郁夫(群馬大学) Sn-Bi 共晶合金の組織に及ぼす In 添加の影響 *田中章吾, 鶴田裕也, 上西啓介(大阪大学), 上村泰紀, 赤松俊也, 作山誠樹(株富士通研究所) Sn-Bi 合金の機械的特性に及ぼす合金元素の影響 *山内 啓, 井田健太, 大山拓人(群馬高専) Bi 系高温鉛フリーはんだの引張特性に及ぼす温度と歪み速度の影響 *張 海東, 荘司郁夫(群馬大学), 下田将義, 渡邊裕彦(富士電機株) 	<p>[C-1] 熱マネジメント1</p> <ol style="list-style-type: none"> 3D-ICの熱設計に向けた BEOL 層の熱特性計測手法 *大貫浩史, 中村直章(富士通アドバンステクノロジ株), 菊池俊一(富士通株) チップキャリアと放熱板の設計が 2.5D パッケージの放熱特性に与える影響 *山田靖治, 久田隆史(日本アイ・ピー・エム株) 3次元積層チップのための基板側からの放熱方法の検討 *松本圭司, 森 裕幸, 折井靖光(日本アイ・ピー・エム株) マイクロチャネル冷却構造を内蔵した LTCC モジュールの開発 *谷口 淳, 水野義博(株富士通研究所) 車載用次世代アルミ直接水冷モジュール *郷原広道, 稲葉祐樹, 両角 朗, 西村芳孝, 玉井雄大, 齊藤 隆, 百瀬文彦, 望月英司, 高橋良和(富士電機株) グラファイトパウダーを用いた柔軟性を有する高熱伝導熱シートの開発 *北浦秀敏, 田中篤志, 中谷公明, 西川和宏, 西木直己(パナソニック株)
11:00	休憩		
11:10 ~ 12:50	<p>[A-2] 配線・実装材料の信頼性解析</p> <ol style="list-style-type: none"> Sn-Ag-Cu 合金の微小疲労き裂進展特性とその信頼性解析への応用 *小川賢介, 文倉智也, 荻谷義治(芝浦工業大学), 大井秀哉, 小林卓哉(株メカニカルデザイン) はんだフラックス由来の臭素が関与したウイスカ状突起物の発生 *斎藤 彰(株村田製作所) スルーホールビア用銅めっき薄膜の低サイクル疲労寿命 *矢島直幸, 大日方 策, 荻谷義治(芝浦工業大学), 菊池俊一, 広島義之, 松井重紀子(富士通アドバンステクノロジ株), 清水浩(日立化成株) 外部応力型ウイスカ抑制はんだ合金の検討 *岩本博之, 宗形 修, 鶴田加一(千住金属工業株) 応力による欠陥発生と消失のメカニズム解明 *孫 静文, 澁谷忠弘(横浜国立大学) 	<p>[B-2] 3D 実装</p> <ol style="list-style-type: none"> 【講演】3D IC の最近の技術動向と低コストガラスインターポーザへの挑戦 *佐藤陽一郎(旭硝子株) 次世代 3D-LSI にむけた Ag-Sn 多層薄膜による低温低加圧接合プロセスとその適正化に関する研究 *重本拓己, 米田聖人, 山本崇裕, 佐藤了平, 岩田剛治(大阪大学) TSV ビアフィリングへの適用に向けた Ni 電解めっきのボトムアップ成長機構の解明 *小林竜也, 浅野佑策, 田嶋尚之, 樋口和人(株東芝) 極薄チップの抗折強度測定方法についての考察 *島本晴夫, 青柳昌宏(独)産業技術総合研究所, 長野一昭(株新川), 安永尚司(ローム株), 北市幸佑(ルネサス エレクトロニクス株), 山崎実(Dage ジャパン株), 山田洋一(株島津製作所), 釣屋弘弘(INEMI) 	<p>[C-2] 熱マネジメント2</p> <ol style="list-style-type: none"> ヒートシンカー体型パワーモジュールの開発～放熱性能検査手法の確立～ *三田泰之, 木村 享, 芳原弘行, 中島 泰(三菱電機株) 赤外線サーモグラフィの温度ピーク検出能力に関する実験的検討～拡大レンズの半径及び円周方向の依存性～ 平沢浩一, 有賀善紀(KOA株), *四谷友騎, 執行健誠, 富村寿夫(熊本大学) TIM の接触熱抵抗に関する研究 *斎藤清弘, 鈴木 悟, 小室貴紀(神奈川工科大学) 重力方向に発熱素子が実装された相変化冷却器の熱伝達モデルとその検証 *坂本 仁, 蜂矢真弘, 吉川 実(日本電気株) 高速結晶成長技術による高性能熱電変換デバイス *前嶋 聡, 豊田かおり(パナソニック株)
12:50	昼食休憩		
13:50 ~ 15:20	<p><プレナリーセッション> 「エレクトロニクス製造業における生産技術の課題と次への挑戦」 (A会場)</p> <ol style="list-style-type: none"> エレクトロニクス製造業の成り立ち、課題、そしてその再興に向けて 貫井 孝(大阪大学) プリントドエレクトロニクス技術の展望と課題 鎌田俊英(独)産業技術総合研究所) 		
15:30 ~ 17:30	<p><ポスターセッション>, ポスタープレゼン 15:30~16:15(A会場), パネル説明 16:15~17:30, Coffee Break(5階 フォワイエ)</p> <p>P-1 有機基板に対するガラス配線基板の接続信頼性に及ぼす基板の CTE 差の影響 *土田徹勇起, 中村清智(凸版印刷株), 窪田悠人, 荘司郁夫(群馬大学)</p> <p>P-2 Sn ウィスカの発生に及ぼす Al-Sn 系金属組織の影響 *渡部雄大, 榊田智美, 佐々木淳平, 神谷 修(秋田大学)</p> <p>P-3 フリップチップ接合用アンダーフィル材の密着強度と疲労特性に及ぼすカップリング剤の影響 *三ツ木寛尚, 荘司郁夫, 小山真司(群馬大学)</p> <p>P-4 短繊維強化 PPS の機械的特性に及ぼす繊維含有量と温度の影響 *高橋諒伍, 荘司郁夫(群馬大学), 関 祐貴, 丸山 敏(株山田製作所)</p> <p>P-5 エポキシフラックスの濡れ特性とはんだボール接合部の補強効果 *石山旺欣, 荘司郁夫(群馬大学), 藤部竜也, 渡邊裕彦(富士電機株)</p> <p>P-6 エポキシ系アンダーフィル材の微小疲労き裂進展観察 *佐竹孝治, 荻谷義治(芝浦工業大学), 佐藤敏行, 榎本利章, 山口 博(ナミックス株)</p> <p>P-7 Bi-Sn 共晶合金の微小疲労き裂進展におよぼすひずみ速度および組織の影響 *谷口麻衣子, 小川賢介, 荻谷義治(芝浦工業大学)</p> <p>P-8 試験法標準に準拠した鉛系および非鉛系はんだの力学的基礎データ集構築 *旭吉雅健¹, 伊藤隆基², 稲田将人³, 上西啓介⁴, 上野 明², 小川和洋⁵, 小野泰彦³, 金 泰俊^{1,4}, 久保田一⁶, 坂根政男⁷, 張 聖徳⁷, 塚田 裕⁸, 中本久志¹⁰, 野崎峰男¹¹, 能瀬春雄¹², 外園洋昭¹³, 本間俊王¹⁴, 堤 哲也⁹, 山下満男¹³, 山本隆栄¹⁵ ①石川工業高等専門学校, ②立命館大学, ③株キグチテクノクス, ④大阪大学, ⑤東北大学, ⑥JFE テクノロジー株, ⑦電力中央研究所, ⑧i-PACKS, ⑨株島津製作所, ⑩株コベルコ科研, ⑪兵庫県立工業技術センター, ⑫大阪産業大学, ⑬富士電機株, ⑭株神戸工業試験場, ⑮分大大学)</p> <p>P-9 Ag 微細線の電氣的・熱的特性評価に関する研究 *佐々木崇統, 李 淵, 坂 真澄(東北大学)</p> <p>P-10 電子部品の一般化寿命予測式作成 *山中忠佳, 都築峰幸, 岡田直樹(ASTOM)</p> <p>P-11 低温焼結性銅材料の開発 *井田清信, 友成雅則, 渡辺 満, 磯部 薫(石原産業株)</p> <p>P-12 ダイボンディング用の Au ナノポーラスシートの作製 *松永香織, Kim Min-Su, 西川 宏(大阪大学), 斎藤美紀子, 水野 潤(早稲田大学)</p> <p>P-13 低分子三級アミンを用いた液相還元法による銀ナノ粒子の作製 *脇田城次, 上西啓介(大阪大学)</p> <p>P-14 ナノパーティクルデポジション法で形成した微細円錐 Au パンブを用いたフリップチップパンプ接合部の電気抵抗評価 *根本俊介, 仲川 博, Bui Thanh Tung, Feng Wei, Melamed Samson, 菊地克弥, 青柳昌宏((独)産業技術総合研究所)</p> <p>P-15 有機酸を用いた金属塩生成接合法による Ti/Al の固相接合条件の最適化 *秋山 主, 小山真司(群馬大学)</p> <p>P-16 金属塩皮膜付与 Zn シートの創製と A5052 アルミニウム合金接合部への適用 *馬 小娟, 富川陽平, 秋山 主, 小山真司(群馬大学)</p> <p>P-17 燃焼反応熱を利用した接合とその継手強度評価 *道屋悠真, 小椋 智, 佐野智一, 廣瀬明夫(大阪大学)</p> <p>P-18 超音波 Al リボンボンディングにおける接合界面の摺動挙動 *高嶋万将, 三澤浩太, 安藤雅哉, 高橋康夫(大阪大学), 前田将克(日本大学)</p> <p>P-19 銀粒子と錫粒子の反応による接合部の化合物化と高融点化 *寺尾亜加梨, 上西啓介(大阪大学)</p> <p>P-20 インコネルと貴金属合金のマイクロ抵抗溶接における表面状態の影響 *川上 寛, 福本信次, 松嶋道也(大阪大学), 田邊享一郎, 田中邦弘, 坂入弘一(田中貴金属工業株), 藤本公三(大阪大学)</p> <p>P-21 チタニウム合金 Ti-6Al-4V のフェムト秒レーザーピーニング技術の開発 *岩田匠平, 佐野智一, 廣瀬明夫(大阪大学), 佐野雄二(株東芝)</p>		
17:45	懇親会 (6階 ベイブリッジカフェテリア)		

2月4日(水)

時間	A 会場	B 会場	C 会場
9:00 ～ 10:20	[A-3] ナノマテリアル 12. 銀ナノ粒子を用いたシンター接合材の開発とその評価 *遠藤圭一, 栗田 哲, 永岡実奈美, 三好宏昌(DOWA エレクトロニクス株) 13. 酸化銀ペーストを用いた金-アルミナ接合の継手特性評価 *浅間晃司, 小椋 智, 佐野智一, 廣瀬明夫(大阪大学) 14. 銀ナノ粒子焼結接合部の信頼性及び機械的特性の影響 *巽 裕章, 熊田 翔(三菱電機株), 福田 敦(大阪大学), 山口 博(三菱電機株), 加柴良裕(三菱電機株, 大阪大学) 15. ナノ粒子焼結材の機械的特性に及ぼす空隙のばらつきの影響 *齋藤良信, 余田浩太郎, 奥野翔太, 千 強(横浜国立大学)	[B-3] プリントドエレクトロデバイス 40. 液体分離転写方式による金属ナドットパターン積層フィルムの作製 *辻 隆浩, 谷口淳(東京理科大学) 41. アンビエントエレクトロニクスを志向した調和型接続 *三井亮介, 中島伸一郎(日本航空電子工業株), 野村健一, 牛島洋史((独)産業技術総合研究所) 42. インソール型フレキシブル圧力センサマトリクスの開発 *坂本弘明, 横田知之, 松久直司, 網盛一郎, 染谷隆夫 (東京大学) 43. 銀ナノ粒子をめっき下地とした銅配線のエレクトロミグレーション評価 *富士川 亘, 村川昭, 義原 直, 白髪 潤(DIC株)	[C-3] 部品内蔵基板・パッケージ 68. 【講演】Panel Level Package (PLP)技術の現状と今後の展望 *高橋知子, 勝又章夫, 谷口文彦, 大井田充, 澤地茂典, 井上広司(株)ジェイデバイス 69. 一括積層プロセス (PALAP)による部品内蔵基板の実現 *柳場康成(株)デンソー 70. 光部品内蔵パッケージの開発 *佐々木伸也, 石月義克, 飯島真也, 菅間明夫, 中田義弘, 谷 元昭(株)富士通研究所)
10:20	休憩		
10:30 ～ 12:10	[A-4] パワーデバイス1 16. Pbフリーソルダーペーストを用いたダイボンド接合部のボイド発生評価 *杉本 淳(千住金属工業株) 17. パワーモジュール向け Sn-Cu 系はんだの高信頼化 *宮崎高彰, 池田 靖(株)日立製作所 18. 超小型高耐熱高性能パッケージの開発 *立岡正明, 市村裕司, 堀 元人, 池田良成, 高橋良和(富士電機株) 19. 厚板 Cu 配線セラミックス基板の熱変形メカニズムの解明 *春別府 佑, 谷江尚史, 佐々木康二(株)日立製作所, 千綿伸彦(日立金属株) 20. ラマン散乱を用いたSiCパワーデバイス接合応力評価法の開発 *杉江隆一, 内田智之, 小坂賢一, 遠藤 亮, 山元隆志(株)東レリサーチセンター)	[B-4] プリントドエレクトロニクス 44. 銀ナノワイヤを用いた透明電極技術 *中澤恵理, 原 真尚, 大旗英樹, 内田 博(昭和電工株) 45. 銅ナノ粒子含有ポリシルセスキオキサン薄膜の作製 *手嶋彩由里, 村橋浩一郎, 大塚邦顕(奥野製薬工業株), 御田村紘志, 渡瀬星児, 松川公洋(大阪市立工業研究所) 46. 銅結体の熱分解による銅膜形成技術 *飯田宗作(四国化成工業株) 47. Agナノ粒子インクの直接印刷によるGaN系青色LED電極の常圧形成 *柏木行康, 山本真理, 齊藤大志, 高橋雅也, 大野敏信, 中許昌美(大阪市立工業研究所), 小泉 淳, 重宗翼, 児島貴徳, 藤原康文(大阪大学), 垣内宏之, 青柳伸宜, 吉田幸雄(大研化学工業株)	[C-4] MEMS 71. 低温 Au-Au 接合技術を用いた有機ELパネル作製プロセスの開発 *山田晋也(早稲田大学), 沈 昌勲, 江面知彦(九州大学), 岡田愛姫子, 笠原崇史(早稲田大学), 服部昴治, 安達千波矢(九州大学), 庄子習一, 水野 潤(早稲田大学) 72. MEMS のための瞬間ハンダ接合技術と新たな発熱素子 *生津資大, 黒石隼輝, 井上敬太, 藤戸絵人, 井上尚三(兵庫県立大学) 73. MEMS 気密閉止のためのリフトオフによる超平滑表面電鍍Au封止の常温接合 *倉島優一, 高木秀樹(独)産業技術総合研究所 74. ロールプレス方式を用いた液体分離方式インプリントによるシリコンモールドの作製 *林 竜也, 谷口 淳(東京理科大学) 75. ロールプレスナノインプリントによる微細構造の大面積高速成形技術 *岩瀬鉄平, 石川明弘, 上木原伸幸, 横山信之, 和田紀彦, 那須博(パナソニック株)
12:10	昼食休憩		
13:10 ～ 14:50	[A-5] パワーデバイス2 21. 銀ナノ粒子による高耐熱接合材の開発 *渡辺智文, 武居正史, 下山賢治(バンドー化学株) 22. Ni ナノ粒子を用いた高温実装用ダイアタッチ技術の検討 *松原典忠, 石川信二, 宇野智裕(新日鐵住金株), 清水隆之(新日鐵住金化学株) 23. ナノコンジット構造合金微粉末・Cu+Ag/Sn+Cu ペーストによるSiCパワー素子の遷移的液相焼結(TLPS)接合 *郎 豊群 ¹ , 加藤史樹 ^{1,2} , 仲川 博 ^{1,2} , 山口 浩 ^{1,2} , 佐藤弘 ^{1,2} , 岡田圭二 ³ , 木村竜司 ³ , 進藤広明 ³ , 関根重信 ³⁽¹⁾ 技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構(FUPET), ^{2(独)} 産業技術総合研究所, ^{3(有)} ナプラ 24. 固相線温度を制御可能な金系はんだの高信頼化方法 *高橋弘樹 ^{1,2} , 村上善則 ^{1,3} , 安在岳士 ^{1,4} , 加藤史樹 ^{1,5} , 渡辺衣世 ¹ , 佐藤伸二 ^{1,6} , 谷澤秀和 ^{1,6} , 樋山浩平 ^{1,7} , 佐藤 弘 ^{1,5(1)} 技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構(FUPET), ² 富士電機株, ³ 日産自動車株, ⁴ カルソニックカンセイ株, ^{5(独)} 産業技術総合研究所, ⁶ サンケン電気株, ^{7(株)} 東芝 25. 両面冷却構造用ニッケルスズ液相拡散接合の研究 *浅井林太郎, 加藤武寛, 味岡正樹(トヨタ自動車株)	[B-5] 樹脂実装材料 48. 金属有機化合物及び樹脂補強技術を用いた低温焼成性銀ペースト *佐々木幸司, 水村宜司(ナミック株) 49. はんだ接合部分に樹脂補強効果を持つソルダーペースト *大和準也, 有田良隆(サンキュレック株) 50. アミン系硬化剤を用いたエポキシ系 Cu ペーストの大気中キュアプロセス解析 *乗附高志, 井上雅博, 坂庭慶昭, 勅使河原一成, 多田泰徳(群馬大学) 51. 導電性樹脂接合部の熱特性および界面強度評価 *加藤裕太, 松嶋道也, 福本信次, 藤本公三(大阪大学) 52. ポリアミド樹脂とベンゾオキサジンの複合化による低熱膨張熱硬化性樹脂シートの開発 *藤井飛鳥, 柏崎 史, 森 貴裕(株)ADEKA)	[C-5] 固相接合 76. 多積層金属箔における超音波接合進展メカニズムの研究 *矢野公也, 小林宏直, 弘田実保, 渋谷 誠, 池田治彦(株)村田製作所 77. 473Kにおける(Sn-Cu)/Ni系の固相反応拡散の速度論的挙動 *梶原正憲, 中山美紗子(東京工業大学) 78. クエン酸を用いた金属塩生成接合法による SUS304 ステンレス鋼の固相接合 *常藤達礼, 小山真司(群馬大学) 79. 硝酸と酢酸を用いた金属塩生成法による A6061 合金の精密固相接合 *富川陽平, 小山真司(群馬大学)
14:50	Coffee Break		
15:10 ～ 16:30	[A-6] パワーデバイス3 26. プレスフィット接続部の接触抵抗計測とそれによる接続部の評価 *深田健太郎(大阪大学), 江草稔(三菱電機株), 福本信次, 松嶋道也(大阪大学), 加柴良裕(三菱電機株), 藤本公三(大阪大学) 27. 高温動作パワーモジュール向け接合技術開発 *柳本辰則, 川端大輔, 東久保耕一, 中原賢太, 伊藤悠策, 須藤進吾(三菱電機株) 28. 半導体チップ上へのリード端子の直接超音波接合技術の開発 *坂元創一, 米田 裕, 柳本辰則, 藤野純司, 菊池正雄(三菱電機株) 29. Cu配線付SiN絶縁基板とCuリードを用いた超音波接合技術の開発 *吉田 勇, 藤原伸一(株)日立製作所, 早川誠一(株)日立パワーデバイス)	[B-6] 樹脂実装プロセス 53. 化学的相互作用に起因する金属/樹脂間の接着性変化の解析 *勅使河原一成, 井上雅博, 多田泰徳(群馬大学) 54. フィラー含有ハイブリッド樹脂実装における実装性評価 *山内浩平, 福本信次, 松嶋道也, 藤本公三(大阪大学) 55. エポキシ系導電性接着剤におけるAgフィラーネットワーク形成過程の解析 *坂庭慶昭, 多田泰徳, 井上雅博(群馬大学) 56. 超音波反応場を用いた有機高分子材料のナノコンジット化プロセス *井上雅博, 多田泰徳, 天野祐作(群馬大学), 林 大和(東北大学)	[C-6] マイクロ接合・加工 80. Ni ₃ rou代替 Fe 基ろうによる SUS304 ろう付継手のマイクロ組織と耐食性 *角田貴宏, 莊司郁夫(群馬大学), 石 康道, 松 康太郎, 田口育宏(東京プレイズ株) 81. はんだバンプ微細化による接合強度の長期信頼性への影響 *宇治野 真, 西川 宏(大阪大学) 82. レーザー誘起表面微細クレバス構造を利用した特異拡散流れによる金属接合の試み *中本将嗣, 福田 敦, 佐竹義旦, 松川浩之, 後藤弘樹, 松本 良, 鈴木賢紀, 宇都宮 裕, 田中敏宏(大阪大学) 83. 熱流体力学に基づくアルミニウムのレーザースポット溶接におけるキーホールの形成およびホロシティの生成に関する数値シミュレーション *周 崎楓, 本庄健寛, 森 裕章, 宮坂史和, 上村洋輔, 水谷正海, 川人洋介, 片山聖二(大阪大学)
16:30 ～ 16:50	表彰式 (A会場)		
	閉会の挨拶	Mate2015組織委員会副委員長 青柳 昌宏	(A会場)

※ 掲載内容は、当日変更される場合があります。

組織委員会

委員長	藤本公三 (大阪大学)		
副委員長	青柳昌宏 ((独)産業技術総合研究所)	廣瀬明夫 (大阪大学)	
委員	瀧美幸一郎 (大阪大学)	荒井栄司 (大阪大学)	大西 寛 (三菱電機(株))
	小勝俊巨 (日本電気(株))	小野塚英明 ((株)日立製作所)	小林紘二郎 ((一財)電子科学研究所)
	齋藤重正 (合同会社707ティ・アイ)	佐藤武彦 (大阪大学)	佐藤了平 (大阪大学)
	嶋田勇三 (ナミックス(株))	菅沼克昭 (大阪大学)	高橋康夫 (大阪大学)
	竹本 正 (大阪大学)	田中敏宏 (大阪大学)	西田一人 (パナソニック・アパシフィック(株))
	貴井 孝 (大阪大学)	日置 進 (NPO E-TECH)	二上範之 (シャープ(株))
	益子原學 ((株)サイキューブ)	松村慶一 (インフィテックエム(株))	南二三吉 (大阪大学)
	南尾匡紀 (パナソニック(株))	宮崎則幸 (京都大学)	森 郁夫 ((株)東芝)
	矢野 映 ((株)富士通研究所)	山本治彦 (富士通(株))	吉田 隆 (富士電機(株))

実行委員会

委員長	加柴良裕 (大阪大学)		
副委員長	上西啓介 (大阪大学)	久保雅男 (パナソニック(株))	福本信次 (大阪大学)
委員	赤松俊也 ((株)富士通研究所)	朝倉義祐 (神戸市立工業高等専門学校)	味岡正樹 (トヨタ自動車(株))
	新井 進 (信州大学)	池田 徹 (鹿児島大学)	出田吾朗 (三菱電機(株))
	市村裕司 (富士電機(株))	一山靖友 (日鉄住金テクノロジー(株))	伊藤元剛 ((株)東リリサーチ)
	井上雅博 (群馬大学)	岩田剛治 (大阪大学)	于 強 (横浜国立大学)
	梅本和伸 (日本電気(株))	海老原伸明 (NEC東芝入システム(株))	大口達也 (日本アビオニクス(株))
	大熊秀雄 ((有)エイチ・ティー・オー)	大貴 仁 (茨城大学)	大村悦二 (大阪大学)
	小川倉一 (小川創造技術研究所)	小椋 智 (大阪大学)	折井靖光 (日本アイ・ビー・エム(株))
	鎌田信雄 (化研テック(株))	苅谷義治 (芝浦工業大学)	管野敏之 ((株)MORESCO)
	河野英一 ((株)河野エムイー研究所)	小山真司 (群馬大学)	阪元智朗 (オムロン(株))
	作山誠樹 ((株)富士通研究所)	佐藤 強 ((株)東芝)	佐名川佳治 (パナソニック(株))
	佐野智一 (大阪大学)	三治真佐樹 ((株)デンソー)	穴戸逸朗 (京セラSLCテクノロジー(株))
	柴崎正訓 ((株)タムラ製作所)	澁谷忠弘 (横浜国立大学)	荘司郁夫 (群馬大学)
	角谷 透 ((株)船井電機新応用技術研究所)	節原裕一 (大阪大学)	芹沢弘二 (千住金属工業(株))
	高尾尚史 ((株)豊田中央研究所)	高岡英清 ((株)村田製作所)	高橋邦夫 (東京工業大学)
	武井利泰 (日本精工(株))	津久井勤 (リサーチラボ・ツクイ)	富岡泰造 ((株)東芝)
	富村壽夫 (熊本大学)	豊田良孝 (千住金属工業(株))	中村清智 (凸版印刷(株))
	西浦正孝 (パナソニック(株))	西川 宏 (大阪大学)	浜野寿之 (エスペック(株))
	久田隆史 (日本アイ・ビー・エム(株))	弘田実保 ((株)村田製作所)	藤原伸一 ((株)日立製作所)
	松坂壮太 (千葉大学)	松嶋道也 (大阪大学)	松林 良 (新電元工業(株))
	圓尾弘樹 (パナソニックシステムソリューションズ(株))	水野 潤 (早稲田大学)	三谷 進 (ニホンハンダ(株))
	宮澤 寛 (DOWAメタルテック(株))	村山 啓 (新光電気工業(株))	森 貴裕 ((株)ADEKA)
	安田清和 (大阪大学)	山内 啓 (群馬工業高等専門学校)	山口敦史 (パナソニック(株))
	山下志郎 ((株)日立製作所)	山中公博 (中京大学)	山根常幸 ((株)東リリサーチ)
	山部光治 ((株)東芝)	横沢伊裕 (宇部興産(株))	渡邊 聡 (藤倉化成(株))
	渡辺 潤 (長野沖電気(株))	渡邊裕彦 (富士電機(株))	

会場アクセス

パシフィコ横浜 会議センター

- * みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩3分
- * JR線・市営地下鉄 桜木町駅より徒歩12分
- * 横浜駅よりタクシー7分、シーバス(船)で10分



問合わせ先: Mate 2015 事務局

(TEL) 06-6878-5628, (FAX) 06-6879-7568

(E-mail) mate@sps-mste.jp, (URL) <http://sps-mste.jp/mate2015/src/>